

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零九年三月三十一日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零九年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。
- 二零零九年第一季的總銷售額與二零零八年第四季相比下降 46.2%至 146,500,000 元主要是由於晶圓出貨量下降 47.8%。二零零九年第一季的毛利率為-88.3%，而二零零八年第四季的毛利率為-27.4%主要由於晶圓出貨量和產能利用率大幅下降所致。二零零九年第一季錄得淨虧損 178,400,000 元，二零零八年第四季錄得淨虧損 139,500,000 元。儘管產能利用率急速下滑，公司於二零零九年第一季產生來自於經營活動的淨現金 78,000,000 元。公司已經獲得幾項新的信貸額度，總額約為 240,000,000 元。二零零九年第一季的簡化平均銷售價格為 869 元，與二零零八年第四季的 843 元相比錄得季度升幅 3.1%，與二零零八年第一季的 798 元相比錄得年度增幅 8.9%。
- 以下為本公司於二零零九年四月二十九日就截至二零零九年三月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條規定的披露責任於二零零九年四月二十九日作出本公佈。

以下為本公司於二零零九年四月二十九日就截至二零零九年三月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零九年四月二十九日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零九年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零零九年第一季概要

- 二零零九年第一季的總銷售額與二零零八年第四季相比下降 46.2%至 146,500,000 元主要是由於晶圓出貨量下降 47.8%。
- 二零零九年第一季的毛利率為-88.3%，而二零零八年第四季的毛利率為-27.4%主要由於晶圓出貨量和產能利用率大幅下降所致。
- 二零零九年第一季錄得淨虧損 178,400,000 元，二零零八年第四季錄得淨虧損 139,500,000 元。
- 儘管產能利用率急速下滑，公司於二零零九年第一季產生來自於經營活動的淨現金 78,000,000 元。
- 公司已經獲得幾項新的信貸額度，總額約為 240,000,000 元。
- 二零零九年第一季的簡化平均銷售價格為 869 元，與二零零八年第四季的 843 元相比錄得季度升幅 3.1%，與二零零八年第一季的 798 元相比錄得年度增幅 8.9%

二零零九年第二季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零零九年第二季收入預期增加 58%至 62%。
- 經營開支去除匯兌損益預期介於 79,000,000 元至 83,000,000 元之間。
- 資本支出預期介於 38,000,000 元至 43,000,000 元之間。
- 折舊及攤銷預期介於 203,000,000 元至 206,000,000 元之間

中芯國際首席執行官張汝京博士就本季度的業績表現發表評論 “我們於今年第一季度的收入比先前的指引優勝 7.5%，而我們的季度平均售價按年增長 8.9%。在晶圓收入中，邏輯產品佔 96.9%。我們還看到晶圓訂單和晶片廠使用率自農曆新年後更有明顯的按月增長。訂單顯著回升歸因於客戶補充庫存和中國本土在無線 LAN、移動電話、數字顯示器和其他消費電子產品中的需求增長。自今年初開始，中國政府的各種刺激經濟方案加速了本土復甦，全球客戶繼續利用中芯國際的戰略地位，以爭取中國的市場份額。我們期望 2009 年第二季度的產能利用率將較第一季度提高一倍。

在先進技術方面，我們 45 納米低功耗技術的認證進展良好，其鑒定晶片的良率亦見進步。我們已在上一季度完成從 IBM 轉移 bulk CMOS 的技術，而且其進程正在認證中，有關測試正在我們上海的 300 毫米晶圓廠進行。在中芯國際驗證 IBM 45 納米矽的同時，眾多客戶已成為我們的主要客戶夥伴及參與設計服務。此外，65 納米的客戶低功耗產品認證已進入最後階段。我們已準備就緒，並計劃於 2009 年第三季度進行大量生產。

今年第一季度，我們收到大量 90 納米和 130 納米訂單，反映了其需求恢復。此外，我們看到

在第一季度客戶的投片走勢，客戶的新投片量平均每日超過一個。我們將繼續開拓更多戰略聯盟以便為客戶提供更好服務：如因應於便攜式媒體播放器市場，我們與 Dolphin 合作超低功耗數字模擬音頻轉換器；又例如我們與 FlipChip International 一起提供新一代 300 毫米晶圓凸塊植球及晶圓級封裝服務。我們將繼續致力於與全球夥伴合作，以提高我們的產品組合和服務範圍。

在 2009 年第一季度，儘管市場充滿挑戰，我們從經營活動中產生 7 千 8 百萬美元的淨現金流。2009 年 3 月，我們與中國進出口銀行簽署了一份戰略合作的備忘錄，其中，中國進出口銀行準備提供信貸總額高達人民幣 30 億元（4 億 3 千 8 百萬美元）予中芯國際。作為第一階段的合作，中國進出口銀行已經批准了一項 1 億 4 千萬美元的 2 年期信用貸款予我們。在 2009 年第一季度，本公司已獲得新的貸款總額共約 2 億 4 千萬美元，其中包括以上提及的 1 億 4 千萬美元的信用貸款，這大大強化了我們的財務狀況。

進入 2009 年第二季度，越來越多的訂單令我們感到鼓舞。我們預期 2009 年第二季度的收入將按季增加約 60 %。我們希望最壞的時期已經過去，隨著總體市場繼續復甦，我們正努力在各方面加強我們的運營和財務狀況。”

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：二零零九年四月三十日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-3672(密碼：SMIC)/1-800-260-8140 或香港 852-3002-1672
(密碼：SMIC)。

二零零九年第一季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯

中芯國際集成電路製造有限公司（“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981），是世界領先的集成電路晶片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶片代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45 納米晶片代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶片廠和三座 200mm 晶片廠。在北京建有兩座 300mm 晶片廠，在天津建有一座 200mm 晶片廠，在深圳有一座 200mm 晶片廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯代成都成芯半導體製造有限公司經營管理一座 200mm 晶片廠，也代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶片廠。

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述,包括我們預期在 2009 年第二季度增加產能使用率,預期 65 納米客戶的低功率產品進入量產的時間,與全球合作企業進一步的協作,對未來信用額度的預期,對 2009 年第二季度銷售收入增加的預期,我們對市場復蘇的預期,我們加強營運和財務成績的能力,我們對 2009 年資本支出的預期,以及在隨後“資本概要”和“二零零九年第二季指引”等陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識,儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計,存在重大已知及未知風險、不確定性,以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素,包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際抓住在中國發展機遇的能力、中芯國際繼續加強產品組合、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料,包括其於二零零八年十一月二十八日以 20-F 表格形式呈交予證交會的年度報告,特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份,以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件,包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素,本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意,切勿過份依賴此等前瞻性陳述,此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期(或如無有關日期,則為本新聞發佈日期)的情況而表述。除法律有所規定以外,中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任,亦不擬更新任何前瞻性陳述。

重大訴訟

台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日,台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院,指稱本公司違反和解協議、違反承兌票據及挪用商業機密而對本公司及若干附屬公司(即中芯上海、中芯北京及中芯美國)提出訴訟。台積電要求(其中包括)損害賠償、禁制令、律師費及提早支付和解協議所規定的餘下未付金額。

當前訴訟中，台積電指稱本公司利用台積電之商業機密製造本公司0.13微米或以下製程產品，又指稱由於本公司違約，台積電之專利特許權已終止，且根據二零零五年和解協議有關本公司較大製程產品的不起訴契諾亦已失效。本公司強烈否認所有關於挪用機密的指控。法院並無證據證明台積電之申索有效。本公司於二零零六年九月十三日公佈，除強烈抗辯台積電在美國訴訟的指控外，亦已於二零零六年九月十二日反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反真實公平交易的推定契諾，要求台積電賠償損失。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司與本公司全資附屬公司中芯上海及中芯北京對台積電違反誠信原則、商業詆毀的不公平競爭行為提出的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司要求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、台積電向本公司公開道歉及賠償（包括台積電因侵權行為所獲利潤）。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，要求（其中包括）台積電就違約及違反專利特許協議賠償。台積電隨後否認本公司經修訂反訴中的指控，並追加指控本公司向北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協議。本公司否認台積電所追加的指控。

二零零七年八月十五日至十七日，加州法院就台積電申請臨時禁令禁止本公司的0.13微米邏輯晶圓製程採用若干加工技術進行聆訊。

二零零七年九月七日，法院拒絕台積電提出的臨時禁令申請，故此對本公司的業務發展及銷售並無影響。然而，法院要求本公司若計劃在若干情況下向非中芯國際機構披露邏輯晶圓技術時，須提前十天通知台積電，以便台積電可就該披露提出反對。

二零零八年五月，台積電就本公司的多項反訴向加州法院提交請求簡易判決的申請。本公司反對有關申請，而於二零零八年八月六日，法院決定部份批准並部份駁回台積電的申請。

二零零八年六月二十三日，本公司向加州法院反訴台積電，要求（其中包括）台積電就非法挪用中芯國際的商業機密以提升與中芯國際競爭的能力作出賠償。

二零零八年七月十日，加州法院就台積電申請臨時禁令禁止本公司向第三方披露有關0.30微米邏輯晶圓製程的若干制程技術資料進行聆訊。二零零八年八月八日，法院批准台積電提出的部分申請，臨時禁制本公司披露十四個0.30微米制程步驟。二零零八年十月三日，中芯國際就法院於二零零八年八月八日的判令向加州上訴法院提出上訴，上訴有待審理。

預審時，中芯國際與台積電簽定的二零零五年和解協議的實際條款出現爭議。因此，加州法院在審訊前於二零零九年一月十三至十六日進行初審，純為釐定和解協議的條款及詮釋任何須「會面商討」的規定。二零零九年三月十日，法院發佈決定聲明，決定雙方於二零零五年一月三十日簽署協議，其後在台積電強烈要求下於二零零五年二月二日修訂。法院就此作出最終判決後或會遭中芯國際上訴。

加州法院其後安排於二零零九年九月八日開始審理有關台積電若干商業機密申索與中芯國際商業機密申索的全部責任事宜。

有關本公司於北京市高級人民法院的訟訴，在台積電提出上訴未果後，法院於二零零八年十月十五日、十月二十九日及十一月二十五日舉行聽證會。法院其後並無其他聽證會計劃，預期法院將基於所獲證據公佈裁決。

根據 SFAS 第 144 號的規定，本公司須決定該未決訴訟是否屬於需要進一步分析專利特許組合有否減值的事件。本公司認為，該法律訴訟現處於初步階段，故仍在評估訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將獲得更多資料以助本公司作出決定。根據 SFAS 第 144 號進行的減值分析結果或會嚴重影響本公司財務狀況及經營業績。由於訴訟仍處於初步階段，本公司無法評估不利判決的可能性，亦無法評估可能損失的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

En-Ling Feng

電話：+86-21-3861-0000，內線： 16275

Enling_Feng@smics.com

Anne Wong Chen

電話：+86-21-3861-0000，內線： 12804

Anne_CAYW@smics.com

Edith Kwan

電話：+852-2116-2624

Edith_Kwan@smics.com

二零零九年第一季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	季度比較	二零零八年 第一季度 ⁽³⁾	年度比較
銷售收入	146,519	272,479	-46.2%	362,369	-59.6%
銷售成本	275,900	347,114	-20.5%	394,940	-30.1%
毛利	(129,381)	(74,635)	73.4%	(32,571)	297.2%
經營開支	46,681	46,445	0.5%	170,151	-72.6%
經營虧損	(176,062)	(121,080)	45.4%	(202,722)	-13.2%
其他費用，淨額	(4,480)	(4,146)	8.1%	(3,596)	24.6%
所得稅利益（支出）	3,305	(745)	-	(19,142)	-
稅後淨虧損	(177,237)	(125,972)	40.7%	(225,460)	-21.4%
應佔聯營公司虧損	(874)	(92)	850.0%	(241)	262.7%
淨虧損	(178,111)	(126,064)	41.3%	(225,701)	-21.1%
非控制權益持有人利息	(259)	(13,394)	-98.1%	846	-
普通股持有人應佔虧損	(178,370)	(139,458)	27.9%	(224,855)	-20.7%
毛利率	-88.3%	-27.4%		-9.0%	
經營利潤率	-120.2%	-44.4%		-55.9%	
每股普通股股份淨虧損—基本 ⁽¹⁾	(0.01)	(0.01)		(0.01)	
每股美國預托股份淨虧損—基本	(0.40)	(0.37)		(0.61)	
每股普通股股份淨虧損—攤薄 ⁽¹⁾	(0.01)	(0.01)		(0.01)	
每股美國預托股份淨虧損—攤薄	(0.40)	(0.37)		(0.61)	
付運晶圓（8吋等值） ⁽²⁾	168,682	323,175	-47.8%	454,259	-62.9%
產能使用率	34.9%	67.7%		92.1%	

附注：

(1) 基於二零零九年第一季加權平均普通股 22,344,000,000 股（基本）及 22,344,000,000 股（攤薄），二零零八年第四季 18,948,000,000 股（基本）及 18,948,000,000 股（攤薄），二零零八年第一季 18,579,000,000 股（基本）及 18,579,000,000 股（攤薄）

(2) 包括銅接連件

(3) 根據二零零八年七月二十八日發表的“中芯報告二零零八年第二季的營運結果”中的內容重列

- 二零零九第一季總銷售額由二零零八年第四季的 272,500,000 元下降至 146,500,000 元，錄得季度降幅 46.2%，與二零零八第一季的 362,400,000 元相比錄得年度降幅 59.6% 是由於晶圓出貨量下降所致。
- 二零零九第一季的銷售成本與二零零八年第四季的 347,100,000 元相比，下降 20.5% 至 275,900,000 元主要是由於晶圓出貨量下降所致。
- 二零零九第一季的毛利與二零零八年第四季的負 74,600,000 元相比，增加 73.4% 至負 129,400,000 元，與二零零八第一季的毛利負 32,600,000 元相比增加 297.2%。
- 二零零九第一季的毛利率由二零零八年第四季-27.4% 下降至-88.3%。主要由於出貨量減少和產能使用率下降所致。
- 二零零九第一季的總經營開支與二零零八年第四季的 46,400,000 元相比，錄得季度升幅 0.5% 至 46,700,000 元主要是由於二零零九第一季收到的政府研發補貼減少所致。排除外匯收益，二零零九第一季的總經營開支為 52,600,000 元，二零零九第一季的總經營開支指引介於 53,000,000 元與 56,000,000 元之間。
- 二零零九第一季的研發費用與二零零八年第四季相比，由 12,500,000 元上升 47.7% 至 18,500,000 元，主要由於二零零九第一季收到的政府補助金減少。剔除政府補貼，研發費用錄得季度降幅 6.2% 主要是由於工程實驗相關費用減少所致。
- 二零零九第一季的一般行政費用與二零零八年第四季的 16,100,000 元相比，減少至 14,900,000 元，是由於與經營活動相關的匯兌收益由二零零八年第四季的 2,100,000 元增加至二零零九第一季的 5,900,000 元。
- 二零零九第一季的銷售費用由二零零八年第四季的 5,800,000 元下降至 4,200,000 元，錄得季度降幅 28.0%。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	二零零八年 第一季度
電腦	4.2%	4.5%	12.8%
通訊	50.9%	45.9%	54.3%
消費	32.9%	37.5%	25.9%
其他	12.0%	12.1%	7.0%
以服務分類	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	二零零八年 第一季度
邏輯 ⁽¹⁾	85.3%	85.6%	78.4%
記憶	2.8%	2.6%	12.1%
管理服務	4.1%	2.2%	2.5%
光罩製造，探測及其它	7.8%	9.6%	7.0%
以客戶類別分類	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	二零零八年 第一季度
非廠房半導體公司	70.9%	65.0%	54.4%
集成裝置製造商	11.4%	15.2%	31.6%
系統公司及其它	17.7%	19.8%	14.0%
以地區分類	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	二零零八年 第一季度
北美洲	60.4%	59.9%	53.6%
大中國 ⁽²⁾	32.3%	33.6%	27.7%
亞洲 ⁽³⁾	5.2%	4.1%	6.1%
歐洲	2.1%	2.4%	12.6%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、記憶及銅接連件）	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	二零零八年 第一季度
65 納米	0.1%	-	-
90 納米	8.1%	11.1%	19.8%
0.13 微米	30.8%	34.4%	25.0%
0.15 微米	0.8%	2.2%	4.2%
0.18 微米	31.5%	32.5%	32.1%
0.25 微米	0.4%	0.6%	0.5%
0.35 微米	28.3%	19.2%	18.4%

附注：

- (1) 包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 包括香港和臺灣
- (3) 不包括大中國區

產能*

廠 / (晶圓尺寸)	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度
上海廠 (8 吋) ⁽¹⁾	85,000	88,000
北京廠 (12 吋) ⁽²⁾	33,750	40,500
天津廠 (8 吋)	32,000	32,000
每月晶圓裝配總產能	150,750	160,500

- 產能改變主要由於產品組合的變化

附注:

*期終每月晶圓計 8 吋等值

(1) 上海廠目前包括晶圓一廠, 晶圓二廠和晶圓三廠

(2) 北京廠目前包括晶圓四廠, 晶圓五廠和晶圓六廠

付運及使用率:

8 吋等值晶圓	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	二零零八年 第一季度
付運晶圓 (包括銅接連件)	168,682	323,175	454,259
使用率 ⁽¹⁾	34.9%	67.7%	92.1%

附注:

(1) 產能使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零零九年第一季晶圓付運數量較二零零八年第四季 323,175 片 8 吋等值晶圓減少 47.8% 至 168,682 片 8 吋等值晶圓, 較二零零八年第一季度的 454,259 片 8 吋等值晶圓錄得年度降幅 62.9%。

2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	季度比較	二零零八年 第一季度	年度比較
銷售成本	275,900	347,114	-20.5%	394,940	-30.1%
折舊	130,375	183,916	-29.1%	159,715	-18.4%
其他製造成本	138,791	156,446	-11.3%	227,731	-39.1%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	-	5,886	-
股權報酬	848	866	-2.1%	1,608	-47.3%
毛利	(129,381)	(74,636)	73.3%	(32,571)	297.2%
毛利率	-88.3%	-27.4%		-9.0%	

- 二零零九年第一季的銷售成本與二零零八年第四季的 347,100,000 元相比，下降 20.5% 至 275,900,000 元，主要是由於晶圓付運數量減少所致。
- 二零零九年第一季的毛利與二零零八年第四季的負 74,600,000 元相比，增加 73.4% 至負 129,400,000 元，與二零零八年第一季的負 32,600,000 元相比增加 297.2%。
- 二零零九年第一季的毛利率由二零零八年第四季-27.4% 下降至-88.3%。主要由於出貨量減少和產能使用率下降所致。

經營開支分析

以千美元計	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	季度比較	二零零八年 第一季度	年度比較
總經營開支	46,681	46,445	0.5%	170,151	-72.6%
研究及開發	18,494	12,524	47.7%	34,233	-46.0%
一般及行政	14,928	16,146	-7.5%	18,606	-19.8%
銷售及市場推廣	4,208	5,843	-28.0%	4,884	-13.8%
無形資產攤銷	9,031	11,564	-21.9%	6,784	33.1%
長期資產的減值損失	-	967	-	105,774	-
資產處置損失(收入)	20	(599)	-	(130)	-

- 二零零九年第一季的總經營開支與二零零八年第四季的 46,400,000 元相比，錄得季度升幅 0.5% 至 46,700,000 元主要是由於二零零九年第一季收到的政府研發補貼減少所致。排除外匯收益，二零零九年第一季的總經營開支為 52,600,000 元，二零零九年第一季的總經營開支指引介於 53,000,000 元與 56,000,000 元之間。
- 二零零九年第一季的研發費用與二零零八年第四季相比，由 12,500,000 元上升 47.7% 至 18,500,000 元，主要由於二零零九年第一季收到的政府補助金減少。剔除政府補貼，研發費用錄得季度降幅 6.2% 主要是由於工程實驗相關費用減少所致。

- 二零零九年第一季的一般行政費用與二零零八年第四季的 16,100,000 元相比，減少至 14,900,000 元，是由於與經營活動相關的匯兌收益由二零零八年第四季的 2,100,000 元增加至二零零九年第一季的 5,900,000 元。
- 二零零九年第一季的銷售費用由二零零八年第四季的 5,800,000 元下降至 4,200,000 元，錄得季度降幅 28.0%。

其他收入（支出）

以千美元計	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度	季度比較	二零零八年 第一季度	年度比較
其他收入（支出）	(4,480)	(4,146)	8.1%	(3,596)	24.6%
利息收入	436	1,184	-63.2%	3,758	-88.4%
利息支出	(5,498)	(7,133)	-22.9%	(17,267)	-68.2%
匯兌收益（虧損）	(357)	(2,543)	-86.0%	10,317	-
其他，淨額	939	4,346	-78.4%	(404)	-

- 二零零九年第一季的利息收入下降是由於銀行存款利率大幅降低所致。
- 二零零九年第一季的利息費用由二零零八年第四季的 7,100,000 元下降至 5,500,000 元主要是由於平均貸款餘額減少以及貸款利率下降所致；然而此影響部分被二零零九年第一季收到的政府利息補貼減少所抵消。
- 二零零九年第一季來自於非經營性活動的匯兌損失由二零零八年第四季度的 2,500,000 元下降至 400,000 元。合併來自於經營性活動的匯兌收益，公司於二零零九年第一季整體錄得匯兌收益 5,500,000 元，二零零八年第四季錄得匯兌虧損 400,000 元。
- 二零零九年第一季的其他，淨額由二零零八年第四季的淨收入 4,300,000 元減少至淨收入 900,000 元。

折舊及攤銷

二零零九年第一季的折舊及攤銷總額為 207,800,000 元，相較於二零零八年第四季的 207,700,000 元。

流動資金

以千美元計	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度
現金及現金等價物	502,016	450,230
限制性現金	11,228	6,255
短期投資	20,732	19,928
應收賬款	156,177	199,372
存貨	154,783	171,637
其他	78,728	79,437
流動資產總計	923,664	926,859
應付賬款	135,352	185,919
短期借款	270,078	201,258
長期借款的即期部份	359,080	360,629
其他	144,146	151,967
流動負債總計	908,656	899,773
現金比率	0.5x	0.5x
速動比率	0.7x	0.7x
流動比率	1.0x	1.0x

資本結構

以千美元計	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度
現金及現金等價物	502,016	450,230
限制性現金	11,228	6,255
短期投資	20,732	19,928
長期票據即期部分	29,493	29,242
長期票據	23,792	23,590
短期借款	270,078	201,258
長期借款的即期部份	359,080	360,629
長期借款	533,090	536,518
總借款	1,162,248	1,098,405
股東權益	2,573,891	2,749,365
總債務股本比率	45.2%	40.0%

- 二零零九年第一季的總債務股本比率增加主要是由於二零零九年第一季的淨虧損使股東權益減少所致。

現金流量概要

以千美元計	二零零九年 第一季度	二零零八年 第四季度
來自於經營活動的現金淨額	78,117	171,213
來自於投資活動的現金淨額	(81,785)	(120,085)
來自於融資活動的現金淨額	54,846	6,460
現金變動淨額	51,786	57,349

資本開支概要

- 二零零九年第一季資本開支為 24,000,000 元，二零零九年第一季資本開支指引為 40,000,000 元至 45,000,000 元之間。
- 二零零九年預期的資本開支總額將約為 190,000,000 元，並將根據市場狀況作調整。

近期公佈

- FlipChip International 宣佈與中芯國際達成 300mm 戰略合作關係（二零零九年三月十六日）
- 授出購股期權（二零零九年二月十七日）
- 進一步公告（二零零九年二月十日）
- 董事變更（二零零九年二月五日）
- 中芯截至二零零八年十二月三十一日止三個月業績公佈（二零零九年二月五日）
- 二零零九年二月三日舉行之股東特別大會投票表決結果（二零零九年二月三日）
- 董事變更（二零零九年一月二十九日）
- 中芯國際發佈 3 套 65 納米標準單元庫的初始版本（二零零九年一月二十一日）
- 股東大會特別通告（二零零九年一月十五日）
- 致股東信函：網上電子版通知（二零零九年一月十五日）
- 不獲豁免的持續關聯交易及更新配發及發行股份的一般授權（二零零九年一月十五日）
- 董事變更（二零零九年一月十四日）
- 暫停辦理股份過戶登記（二零零九年一月十二日）
- 董事會會議日期通知（二零零九年一月九日）
- 中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）確定二零零八年第四季度電話會議時間。（二零零九年一月九日）
- 不獲豁免持續關連交易（二零零九年一月八日）
- 股票價格不尋常上升（二零零九年一月七日）

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/cnVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合併資產負債表
(美元)

	截至以下日期止	
	二零零九年 三月三十一日 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 (未經審核)
資產		
流動資產:		
現金及現金等價物	502,015,857	450,229,569
限定用途的現金	11,227,741	6,254,813
短期投資	20,731,562	19,928,289
應收賬款，已扣除撥備分別為 二零零九年三月三十一日 5,870,986 元及二零零八年十二月三十一日 5,680,658 元	156,177,160	199,371,694
存貨	154,783,494	171,636,868
預付款項及其它流動資產	57,287,558	56,299,086
製造機台銷售應收款	21,440,494	23,137,764
流動資產合計	923,663,866	926,858,083
土地使用權，淨額	79,234,650	74,293,284
廠房及設備，淨額	2,792,875,058	2,963,385,840
購入無形資產，淨額	191,028,492	200,059,106
遞延成本，淨額	41,205,077	47,091,516
股權投資	10,756,777	11,352,186
其他長期預付款	1,486,807	1,895,337
遞延稅資產	51,969,380	45,686,470
資產合計	4,092,220,107	4,270,621,822

負債及股東權益

流動負債：

應付帳款	135,351,888	185,918,539
預提費用及其它流動負債	114,185,387	122,173,803
短期借款	270,078,251	201,257,773
長期票據的即期部份	29,492,873	29,242,001
長期借款的即期部份	359,079,883	360,628,789
應付所得稅	467,869	552,006
流動負債合計	908,656,151	899,772,911

長期負債：

長期票據	23,792,341	23,589,958
長期借款	533,090,173	536,518,281
與特許權協定相關的長期應付款	18,375,736	18,169,006
遞延稅負債	373,727	411,877
長期負債合計	575,631,977	578,689,122

負債合計 **1,484,288,128** **1,478,462,033**

非控制權益 34,040,748 42,795,288

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，

於二零零九年三月三十一日及二零零八年十二月三十一日法定及已發行股份分別為 22,350,521,609 股及 22,327,784,827 股。

8,940,209 8,931,114

額外繳入股本 3,491,661,468 3,489,382,267

累計其他綜合（虧損）收入	169,290	(439,123)
累計虧絀	(926,879,736)	(748,509,757)
所有股東權益合計	2,573,891,231	2,749,364,501
總負債及股東權益合計	4,092,220,107	4,270,621,822

合併營運報表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 三月三十一日 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 (未經審核)
銷售額	146,518,884	272,478,762
銷售成本	275,899,824	347,114,296
毛利	(129,380,940)	(74,635,534)
經營費用 (收入):		
研究和開發	18,494,784	12,523,835
一般及行政	14,927,735	16,146,415
銷售和市場推廣	4,207,593	5,843,252
購入無形資產攤銷	9,030,614	11,563,678
長期資產減值損失	-	966,667
來自廠房設備和其他固定資產的銷售損失 (所得)	20,484	(598,819)
經營費用總額	46,681,210	46,445,028
經營虧損	(176,062,150)	(121,080,562)
其他收入 (支出):		
利息收入	436,294	1,183,576
利息支出	(5,498,154)	(7,132,535)
匯兌虧損	(357,034)	(2,542,966)

其他收入, 淨額	938,969	4,346,182
其他支出, 淨額	(4,479,925)	(4,145,743)
所得稅前虧損	(180,542,075)	(125,226,305)
所得稅利益 (支出)	3,304,513	(745,310)
股權投資虧損	(873,513)	(92,319)
淨虧損	(178,111,075)	(126,063,934)
非控制權益持有人利息	(258,904)	(13,394,087)
普通股持有人應佔虧損	(178,369,979)	(139,458,021)
每股股份淨虧損, 基本	(0.01)	(0.01)
每股美國預托股份淨虧損, 基本	(0.40)	(0.37)
每股股份淨虧損, 攤薄	(0.01)	(0.01)
每股美國預托股份淨虧損, 攤薄	(0.40)	(0.37)
用作計算基本每股普通股 虧損額的股份	22,343,640,476	18,947,602,493
用作計算攤薄每股普通股 虧損額的股份	22,343,640,476	18,947,602,493

合併現金流量表
(美元)

截至以下日期止三個月

二零零九年
三月三十一日
(未經審核)

二零零八年
十二月三十一日
(未經審核)

經營活動:

淨虧損 (178,111,075) (126,063,934)

淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整:

遞延稅 (6,321,059) (1,924,575)

處置設備及其他長期資產損失(收益) 20,484 (598,820)

折舊及攤銷 196,535,950 193,779,737

購入無形資產攤銷 9,030,614 11,563,678

股權報酬 2,272,359 2,358,942

長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的非現金利息費用 1,046,426 1,480,674

股權投資虧損 873,513 92,320

長期資產的減值損失 - 966,667

營運資產及負債的變動:

應收賬款, 淨額 43,194,535 86,502,133

存貨 16,853,373 61,385,789

預付款及其它流動資產 (579,942) (5,798,143)

應付賬款 (6,456,221) (36,579,576)

預提費用及其它流動負債 (158,281) (15,985,881)

應付所得稅	(84,138)	34,327
經營活動所得現金淨額	78,116,538	171,213,338
投資活動：		
購入廠房、設備及土地使用權	(72,018,394)	(129,327,507)
政府授予購買廠房及設備所得款項	6,437,831	4,181,922
出售設備所得款項	1,700,577	913,738
出售待售資產所得款項	770,931	–
購買所獲無形資產	(12,621,260)	(23,315,762)
購買短期投資	(31,496,963)	–
購買股權投資	(278,103)	–
出售短期投資	30,693,690	30,717,248
轉換限定用途的現金	(4,972,928)	(3,254,813)
投資活動所耗現金淨額	(81,784,619)	(120,085,174)
融資活動：		
短期借款所得款項	182,644,921	57,407,359
償還短期借款支付的款項	(113,824,443)	(68,750,000)
長期借款所得款項	–	39,397,145
償還長期借款支付的款項	(4,977,014)	(174,736,605)
償還票據支付的款項	–	(15,000,000)
行使發行普通股所得款項	–	168,100,000
行使僱員購股權所得款項	15,937	42,307
償還非控制股權支付的款項	(9,013,444)	–

融資活動所耗現金淨額	54,845,957	6,460,206
匯率變動的影響	608,412	(239,821)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	51,786,288	57,348,549
現金及現金等價物一期間開始	450,229,569	392,881,020
現金及現金等價物一期間結束	502,015,857	450,229,569

於本公告的日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事周杰先生及汪正綱先生（周杰先生的替任董事）、以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生、楊雄哲先生及江上舟先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國上海，二零零九年四月二十九日

* 僅供識別